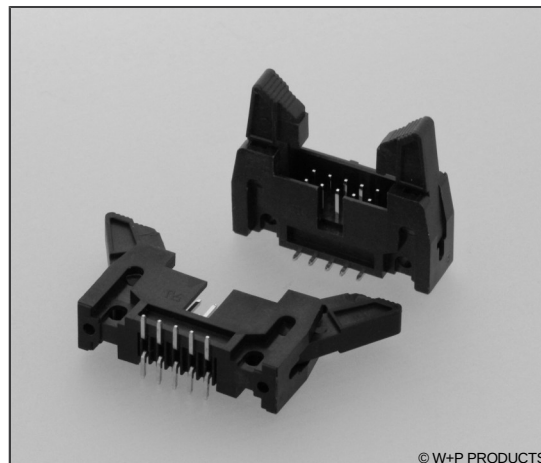


SMT-Wannenstifflisten mit Verriegelung RM 2,54mm, stehend SMT Box Headers with Latches, 2.54mm Pitch, Vertical

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Au über Ni
Contact Surface	Au over Ni
Durchgangswiderstand	20 mΩ max.
Contact Resistance	20 mΩ max.
Isolationswiderstand	1000 MΩ min.
Insulation Resistance	1000 MΩ min.
Spannungsfestigkeit	1000 V AC/DC
Test Voltage	1000 V AC/DC
Nennstrom	3.0 A
Current Rating	3.0 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung	230 °C für 30-60 Sekunden (260 °C für 10 Sekunden)
Processing	230 °C for 30-60 seconds (260 °C for 10 seconds)

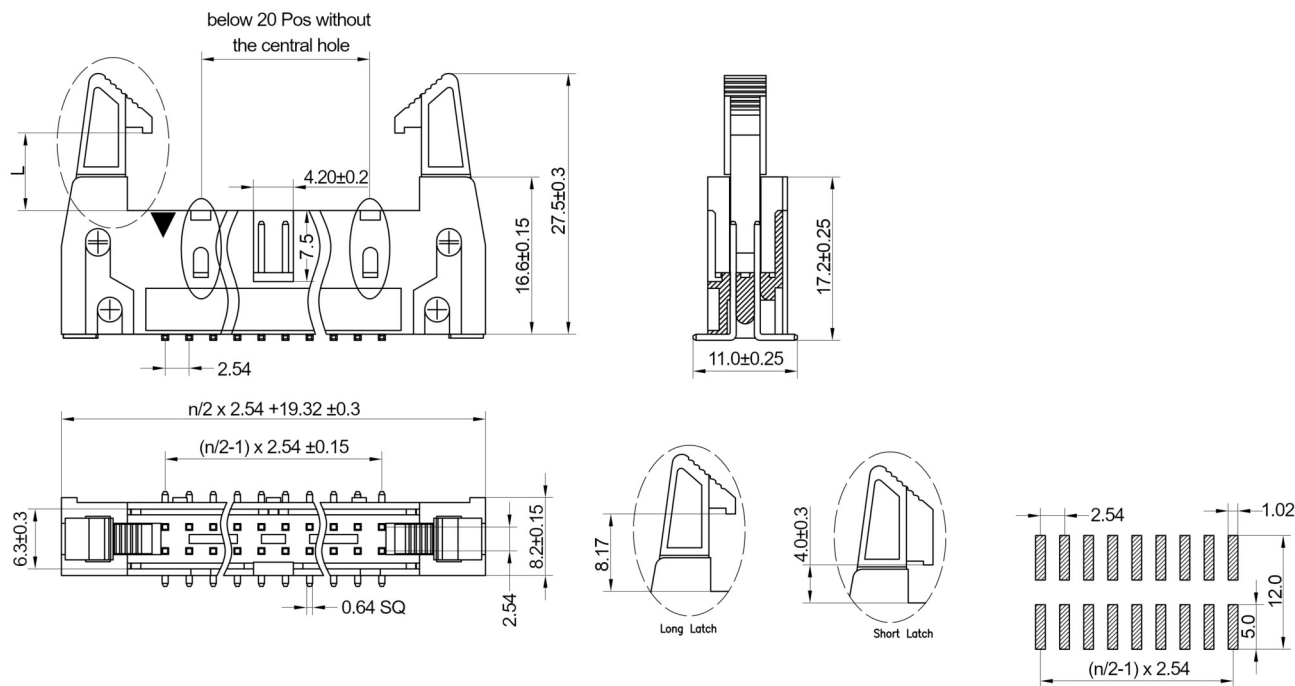


© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker Serie:
Compatible Connector Series:

141

Lange Hebel für Gegenstecker mit Zugentlastung
Long Latches for Mating Connectors with Strain Relief



Series	Contacts*	Latches*	Plating	Packaging*
46-1380	040 006-040	00 00 Ohne Hebel W/o latches 10 Kurze Hebel Short latches 20 Lange Hebel Long latches	00 00 Vergoldet Gold plated	ST 00 ST PPST

Lieferformen / Packaging Options:

00 Im Blister / In the blister
ST In Stangen / In tubes
PPST In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads

* Dies ist ein Bestellbeispiel -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an order example -
please replace by your specifications.

Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	untere Temperaturangabe [°C]
Verweildauer oberhalb T_L	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	obere Temperaturangabe [°C]
Dauer Höchsttemperatur	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	Lower Temperature [°C]
Duration above T_L	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	Upper Temperature [°C]
Duration Peak Temperature	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

